

版数 REV.	年月日 DATE	DON NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	24.Nov.2005	058588	ADDED NEW ITEMS		K.INOUE		<i>Ot. Hashiguchi</i>

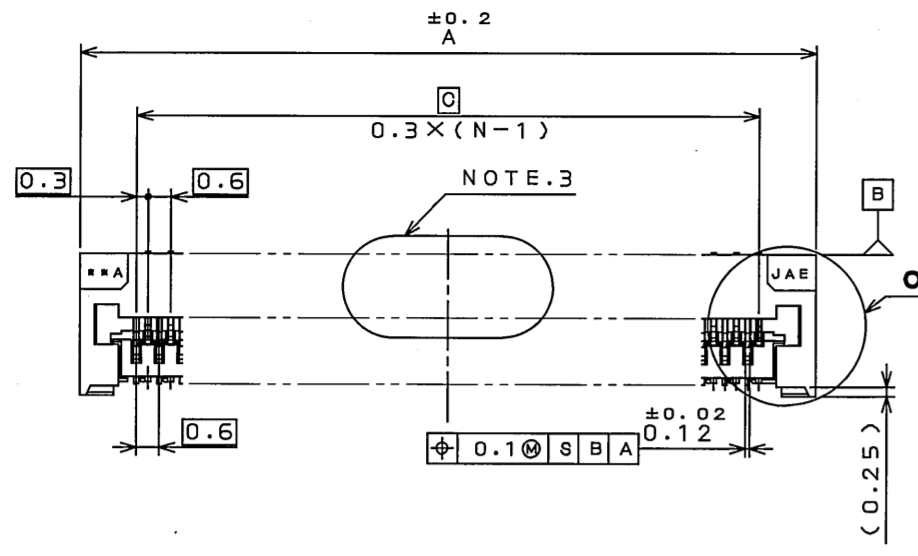
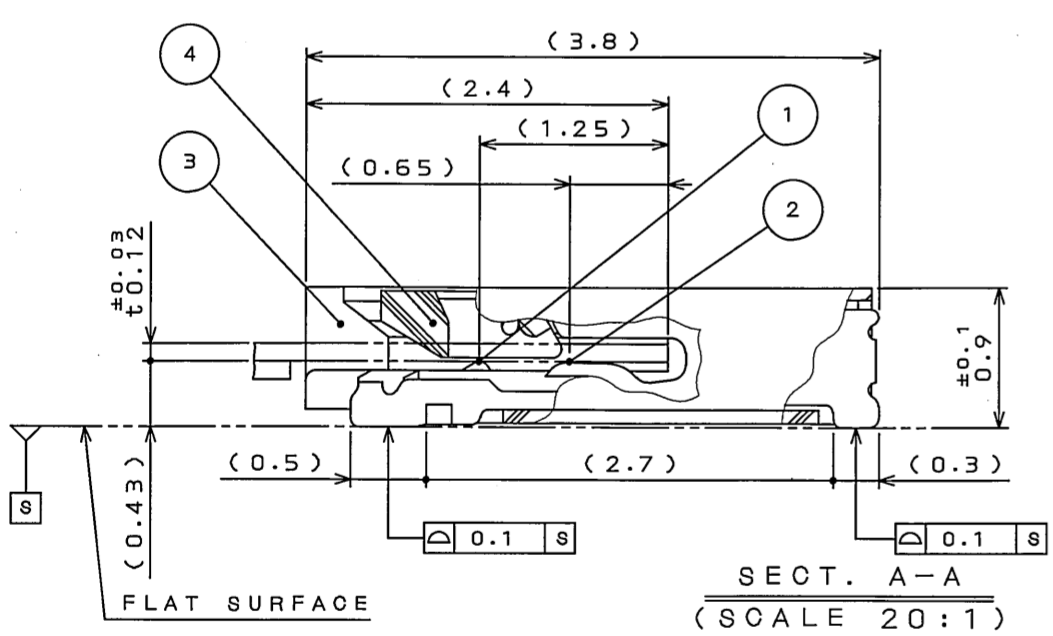
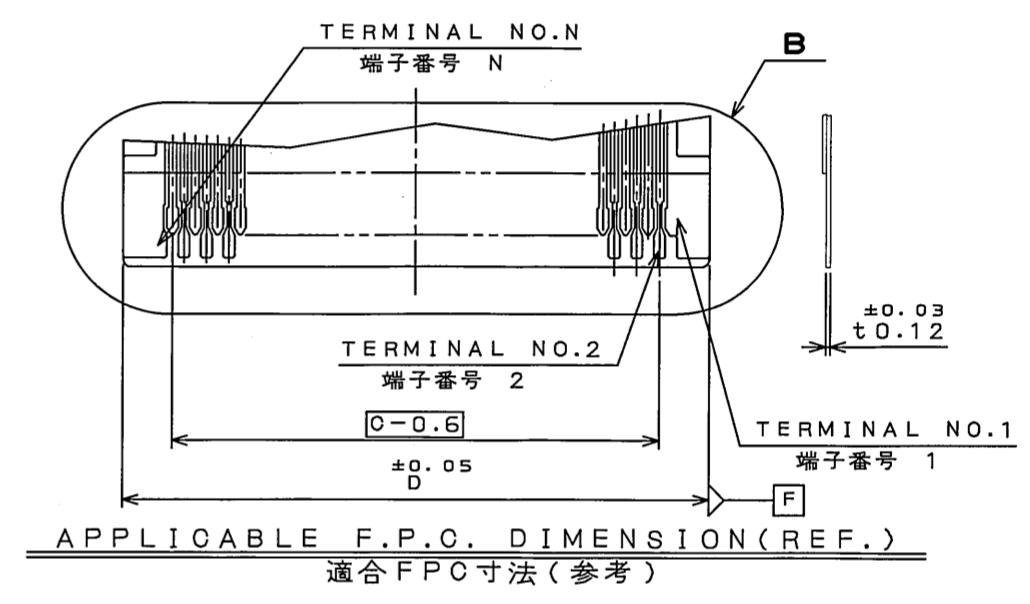
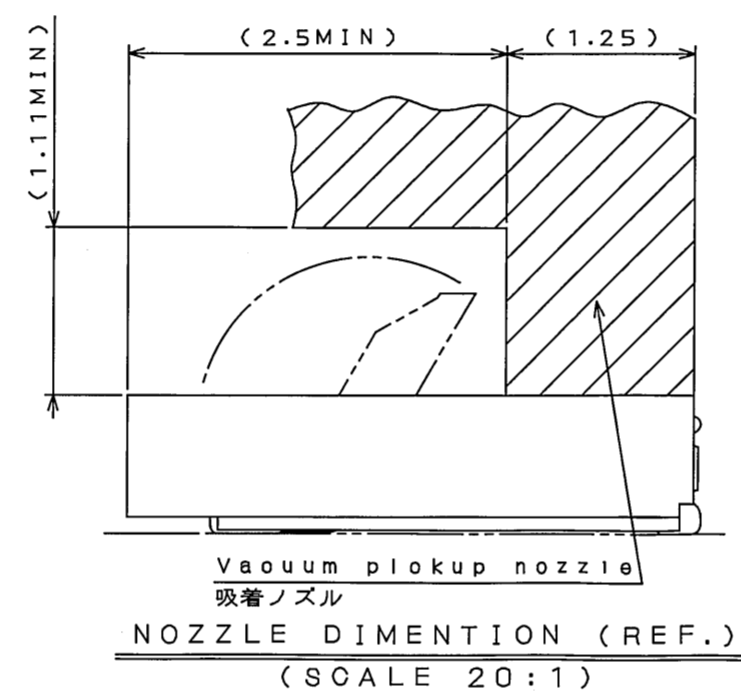
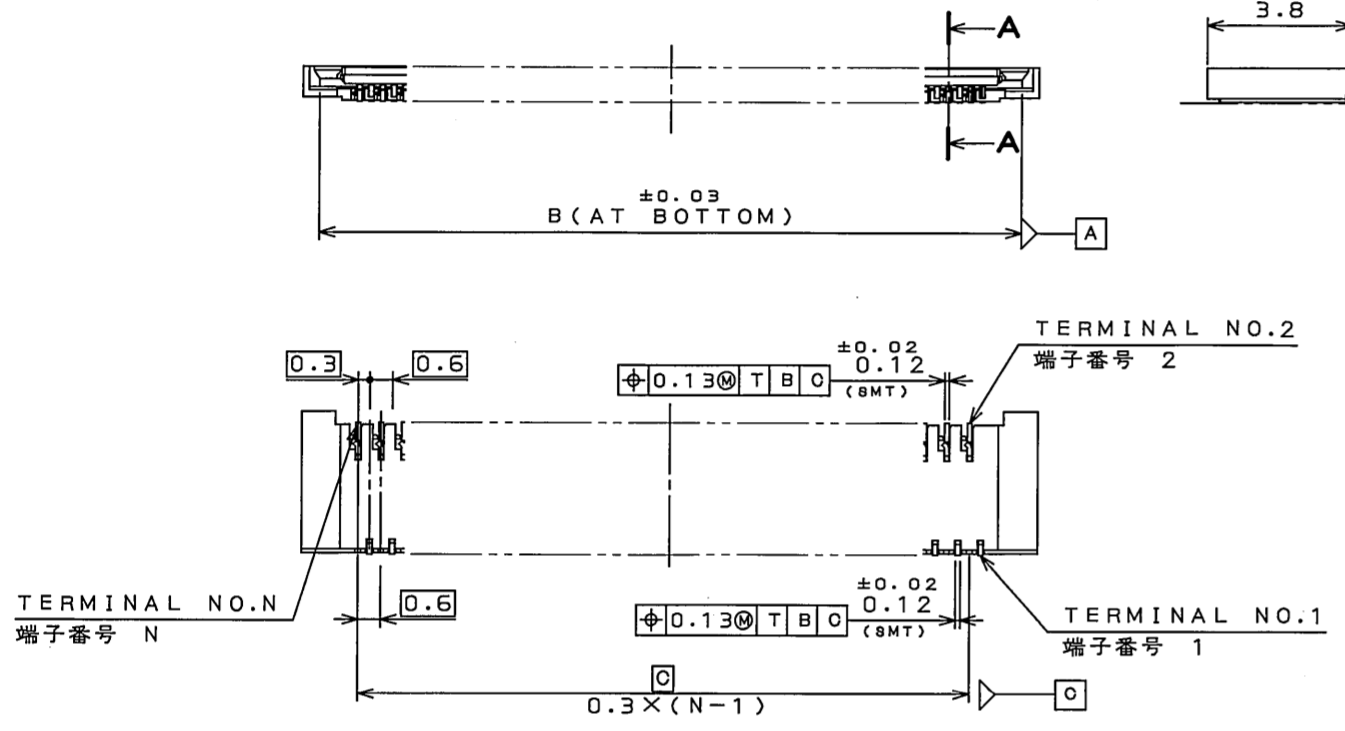
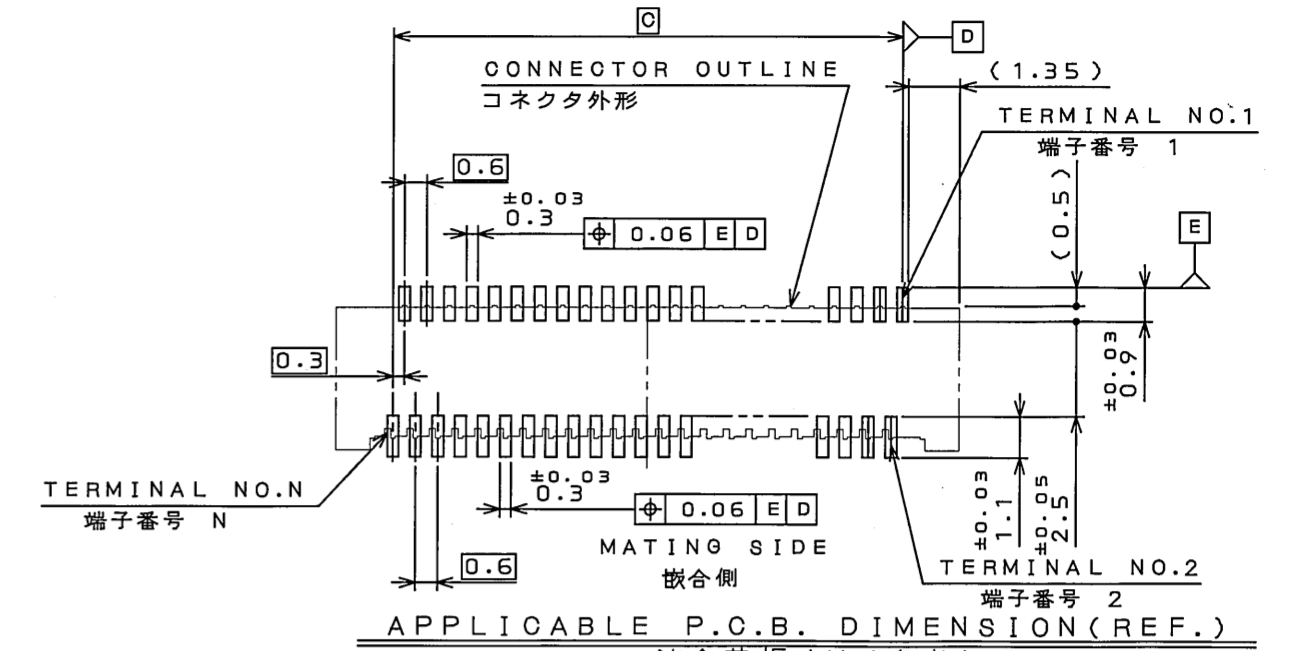


TABLE 1

PRODUCT NO. 品名	A	B	C	D
FF02860SV1	20.7	19.81	17.7	19.74
FF02850SV1	17.7	16.81	14.7	16.74
FF02840SV1	14.7	13.81	11.7	13.74



NOTE 1. REFER TO TABLE 2 ABOUT RECOMMENDED FPC COMPOSITION.
 NOTE 2. TOLERANCE OF DIMENSION D IS RECOMMENDED TO BE ± 0.05 IN ORDER TO IMPROVE PRECISION OF PITCH POSITIONING AND CONNECTION RELIABILITY.
 NOTE 3. LOT NUMBER IS MARKED ON THE TOP CENTER PORTION OF THE CONNECTOR.

注1. 推奨FPC構成はTABLE2参照のこと。
 注2. 寸法Dはピッチ方向の位置決め精度を高め接触信頼性を高めるために ± 0.05 を推奨する。
 注3. ロット番号がコネクタ上面中央部に表記される。

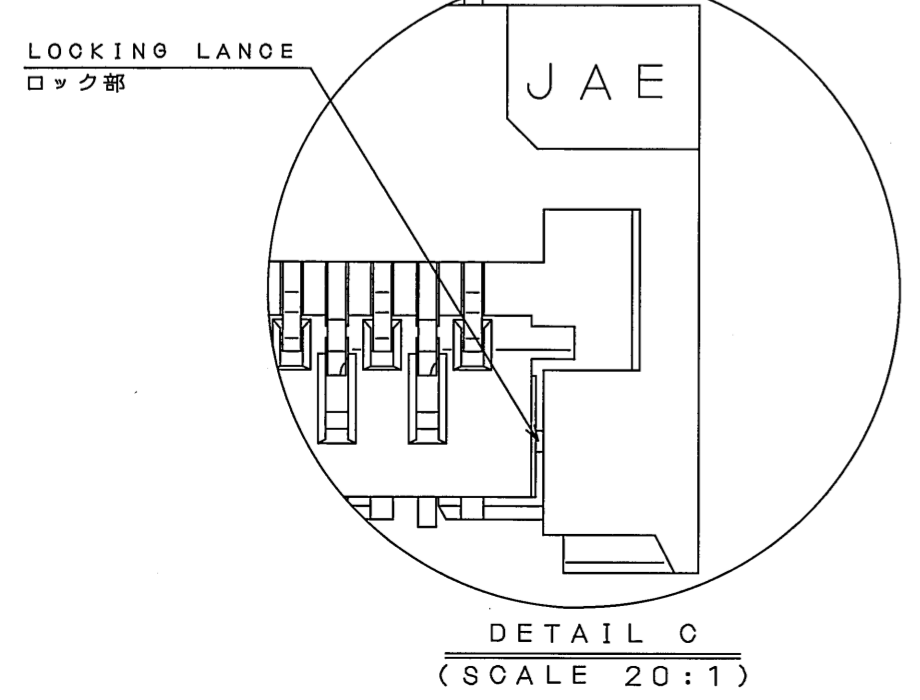
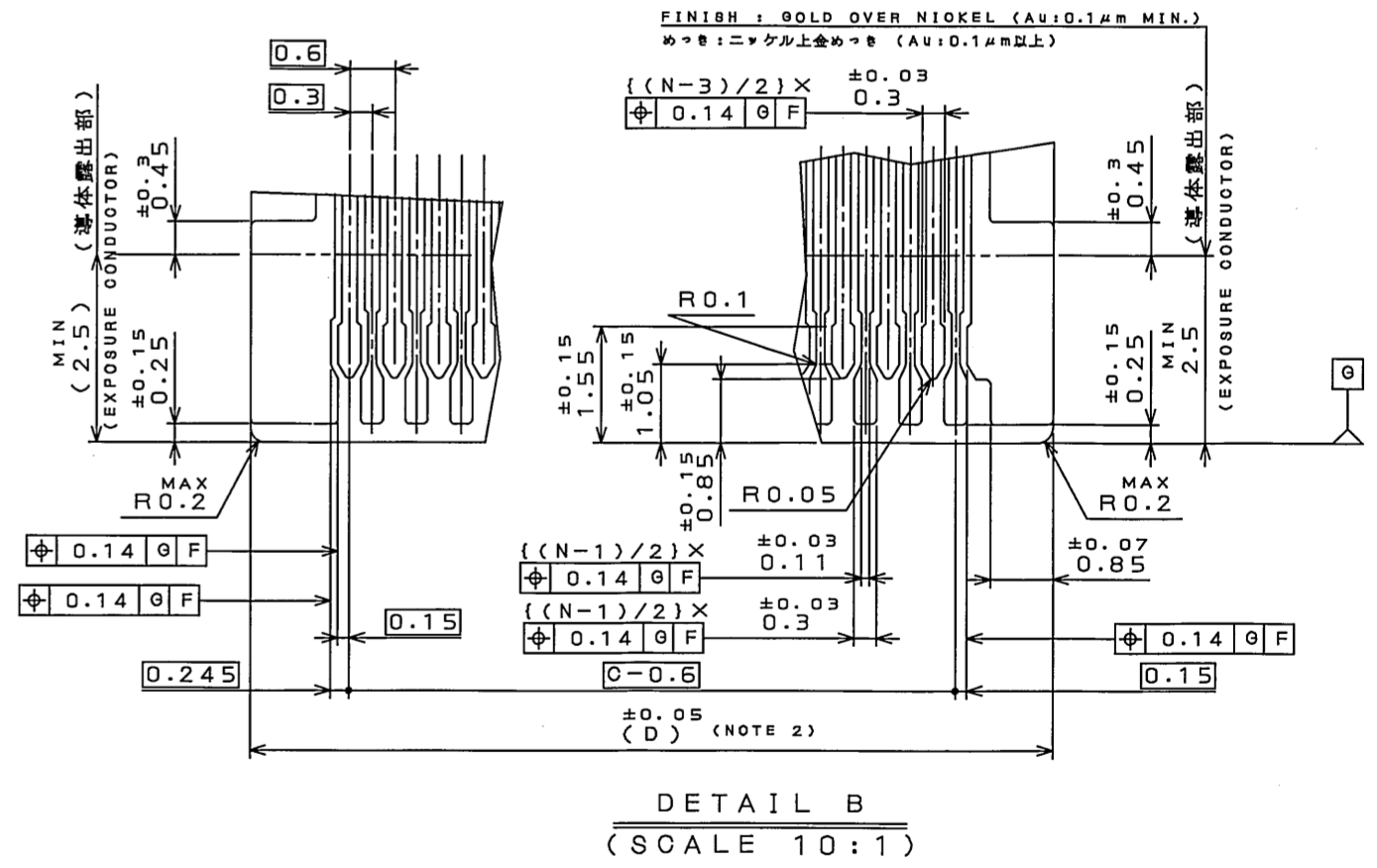


TABLE 2

COMPOSITION 層名		RECOMMENDED 推奨
GOLD PLATING 金めっき	ELECTROLYSIS PLATING 電解めっき	0.1 μm MIN
NICKEL PLATING ニッケルめっき	ELECTROLYSIS PLATING 電解めっき	SOFT TYPE IF AVAILABLE
COPPER 銅箔	ROLLED MATERIAL 圧延銅	NOMINAL 18 μm MAX
ADHESIVE 接着剤	THERMOSETTING ADHESIVE 熱硬化性	NONE (RECOMMENDED)
BASE FILM ベースフィルム	POLYIMIDE ポリイミド	25 μm
ADHESIVE 接着剤	THERMOSETTING ADHESIVE 熱硬化性	30 μm MAX
REINFORCE PLATE 補強板	POLYIMIDE ポリイミド	

4	ACTUATOR アクチュエータ	1	PPS		COLOR:BLACK/色相:黒 UL94V-0
3	BASE INSULATOR ベースインシュレータ	1	LCP		COLOR:WHITE/色相:白 UL94V-0
2	CONTACT 2 コンタクト 2	N	COPPER ALLOY 銅合金		PARTIAL GOLD OVER NICKEL(AU:0.1μm MIN.) ニッケル上部分金(AU:0.1μm 以上)
1	CONTACT 1 コンタクト 1	N	COPPER ALLOY 銅合金		PARTIAL GOLD OVER NICKEL (CONTACT 2 AND 1) (AU:0.1μm MIN.) ニッケル上部分金 (コンタクト2と1) (AU:0.1μm 以上)
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
仕様書 (SPECIFICATION)	JAOS-10293-*	第1版 (ORIGINAL DATE) 14.JULI.2005	尺 (SCALE) 5:1	シリーズ (SERIES) FF02S	日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.
公差 (GENERAL TOLERANCE)		担当 CHK. K.INOUE	名称 (TITLE) FF02S * SV1	偶数 NUMBER OF CONTACTS (偶数芯数)	図面番号 (DRAWING NO.) SJ104400
寸法 (DIMENSION)	角度 (ANGLES)	査閲 APPD.	承認 APPD. O.HASHIGUCHI	質量 (MASS)	版数 (REV.) 2
. ±0.8	° ±				
.X ±0.4	°X ±				
.XX ±0.1					
.XXX ±					